



HP Proliant BL465c G5 刀片服务器

产品说明



HP Proliant BL465c G5刀片服务器 具备出色的性能和可靠性,同时提 供了卓越的能耗效率和计算密度。 它采用四核AMD Opteron™处理器 和DDR2内存,具备行业领先的工具 和选件,能够使您以经济的价格轻 松拥有高性能计算环境,满足苛刻 的业务需求。 目前,企业需要以更低的成本实现更高的计算性能、可用性和能源利用率。要克服这些严峻的挑战是非常困难的,选择合适的刀片服务器可以助您一臂之力。您需要根据自己的购买能力选择一款高性能的刀片服务器,同时不会导致能源成本增加或影响部署密度。HP ProLiant BL465c G5 刀片服务器将是您的理想选择。

惠普刀片服务器能够支持您运营业务所必需的各种关键应用。惠普刀片服务器功能强大且性能可靠,可提供惠普机架式和塔式服务器所具备的各种特性,而且它们的价格更经济,所需的维护时间更短,并能够随着业务的增长轻松进行扩展。不论您是希望运行各种可扩展的应用,还是打算继续运行当前的应用和操作系统,惠普刀片服务器都能够帮助您实现业务目标。

BL465c G5刀片服务器不仅具备企业级的性能和可靠性,在能源利用率和计算密度方面也同样出色。它能够满足企业级应用的性能需求,而且价格十分经济,符合大多数中型数据中心、部门或分支机构的要求。BL465c G5还集成了各种ProLiant管理工具,例如增强的Integrated Lights-Out 2 (iLO 2)远程管理功能。这些管理工具简化了服务器部署和生命周期管理,能够大大节省IT资源。

HP ProLiant BL465c G5刀片服务器采用四核 AMD Opteron™理器、DDR2内存和串行I/O 技术,能够显著提高系统可扩展性与性能。

主要特性和优势

以经济的价格实现企业级性能

ProLiant BL465c G5能够以经济的价格实现企业级性能、可靠性和灵活性,是大中型数据中心的理想选择。ProLiant 管理工具简化了服务器部署和生命周期管理流程,而且BL465c G5的配置灵活多样,可支持各种应用。另外,BL465c G5刀片服务器具备卓越的技术性能,可显著提高资源利用率。

 Proliant BL465c G5最高支持2路四核AMD Opteron 2300系列处理器,带AMD Virtualization™技术,能 够在虚拟环境中提高系统性能

| 问题 | 传统机架式服务器 | HP BL465c G5 |
|----|-----------------------------|----------------------------------|
| 成本 | 采购、运行和维护成本 较高 | 行业领先的性价比/每瓦 性能比 |
| 时间 | 工作效率低下且无法有 效抓住新的业务机遇 | 可靠性较高,很少发生 宕机事故 |
| 变更 | 采用固定连接方式,灵活性 较低且变更流程非常复杂 | 具备远程管理能力,能对 服务器的问题快速做出响应 |
| 能源 | 系统效率低下且能耗较高, 增加了电源成本 | Thermal Logic 面板可有效 控制系统功耗和散热 |

- 最高支持32GB的ECC 667MHz DDR2 Registered DIMM, 具备内存交叉存取功能, 有助于提高系统性能
- 具备2个夹层卡扩展插槽和2个热插拔SAS或SATA硬 盘托架,有助于实现灵活的配置和部署
- 集成有HP Smart Array E200i控制器,带64MB读高速 缓存和可选的电池支持的写高速缓存,能够提高磁盘 性能和可靠性

面向密集型计算环境的最新技术

HP ProLiant BL465c G5具备卓越的性能和可扩展性、业界领先的管理工具以及用于计算密集型环境的最新技术。它是一款出色的高性能计算(HPC)解决方案,能够为需要高带宽和低延迟系统内存访问的应用提供强大支持。

- 能够在不影响功能的情况下提高64位系统的部署密度
- 最多支持8个Registered DDR2 DIMM内存扩展插槽
- 采用 2块 SFF 插拔 SAS 硬盘, 带电池支持的写高速缓存
- 两个夹层卡扩展插槽可同时支持多个1/〇卡

简化部署和生命周期管理

BL465c G5可为您提供企业级性能和可靠性。Proliant管理工具能够简化服务器部署和生命周期管理。另外,该服务器的配置灵活多样,能够支持各种业务计算应用。

- Integrated Lights-Out 2 (iLO 2) Standard Blade Edition 管理软件是BL465c G5的标配组件,它是一款业界领 先的高性能带外远程管理解决方案,包括虚拟KVM和 图形远程控制台,而且无需客户支付额外的费用。
- iLO Power Management Pack软件可以对服务器功耗和 散热情况进行集中控制,从而提高可靠性并节约能源。
- HP Power Regulator随所有服务器一起提供,能够提供 创新的基于ROM的电源管理,可显著降低服务器功耗, 提升系统性能,满足服务器的功耗需求。
- Insight Control Environment for HP BladeSystem 随所有机箱一起提供,是一款易于安装的软件套件。它可以提供全面的系统状态监控、远程控制、漏洞扫描、补丁管理和电源管理,并能够帮助用户灵活地执行部署。
- ilO 2 Select Pack是可选的升级软件,可提供额外的安全性、电源管理和基于脚本的虚拟介质等功能。

技术规格

HP ProLiant BL465c G5刀片服务器



| 处理器和内存 | | |
|----------------------|---|--|
| 处理器数量 | 1-2 | |
| 最大核心数 | 8 | |
| 支持的处理器 | 四核AMD Opteron TM 处理器: 2356处理器(2.3GHz) 2354处理器(2.2GHz) 2352处理器(2.1GHz) | |
| 低功耗处理器产品 | 支持 | |
| 高速缓存 | 每个核心 512KB 二级高速缓存 2MB 三级高速缓存 | |
| 最大HyperTransport速度 | 1GHz | |
| 内存类型 | PC2-5300 DDR2 Registered DIMM | |
| | 2 GB | |
| 最大内存 | 64GB (8 x 8GB) | |
| 高级内存保护 | Advanced ECC | |
| 存储 | | |
| 存储类型 | 热插拔 SFF SAS 热插拔 SFF SATA | |
| 最大内部存储 | 292GB | |
| 最大内置硬盘托架数 | 2 | |
| 扩展插槽 | 2 | |
| 存储控制器 | Smart Array E200i | |
| 光纤通道 SAN 支持 | 支持 | |
| 部署 | | |
| 外形 | 刀片 | |
| 每机箱内的最多刀片服务器数 | 10U机箱中可安装 16台刀片服务器,6U机箱中可安装8台刀片服务器 | |
| 网络 | 2个嵌入式NC370i 多功能千兆服务器适配器 1 个专用于 iLO 2 Management 的 10/100服务器适配器 | |
| 远程管理 | Integrated Lights-Out 2 Standard Blade Edition | |
| 电源 | 机箱电源 | |
| 保修(部件/人工/现场) | 3年/3年/3年 | |
| 要了解更多技术规范,请参考ProL | iant BL465c G5 QuickSpecs,网站为:http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12796_div/12796_div.PDF | |
| · | | |

灵活的配置和部署选项

BL465c G5 刀片服务器具备许多标准特性,如高性能 Smart Array控制器和多功能千兆以太网卡,能够满足当前各种计算应用的苛刻要求。用户可以将BL465c 安装到 c7000或c3000刀片服务器机箱中,前者主要用于大型 数据中心环境,后者则用于具备较高计算需求的小型部 署环境。BL465c G5 刀片服务器具备 2 个夹层卡插槽,2 个热插拔硬盘托架和各种直连刀片选件,能够帮助您根据自身的需求轻松构建系统。

- 低电压处理器可实现每U最高性能以及每瓦最高性能, 可降低系统发热量,优化系统的功耗
- 本地存储选件包括高性能的SFF热插拔串口硬盘和电池 支持的写高速缓存选件,可有效防止数据丢失
- 通过可选的光纤通道、以太网和InfiniBand 夹层卡实现 I/O扩展
- 直连刀片可以增加本地存储容量,添加磁带备份或者 提供PCI卡扩展

为何惠普的刀片服务器优于其它同 类产品?

惠普独特的技术创新可解决您面临的最大问题。惠普拥有各种得天独厚的资源,我们对惠普的先进技术进行了整合,使惠普刀片服务器更加易用、性能更高。

- Thermal Logic技术:这种智能技术时刻都在为您节约能源,它可以减轻空调系统的压力,将能耗降低30%1
- 虚拟连接架构:只需一次连接,随后可自由添加、更 换或恢复服务器,不影响网络和存储,也不会产生额 外的操作步骤
- Insight Control管理:该软件包提供了各种必需的管理工具,能够简化运营,将管理员的工作效率提高 10 倍
- NonStop 中央隔板:这种用于确保华尔街安全运营的 技术同样能为您的企业和运营提供可靠的保障
- 板载管理器:操作向导可帮助您快速部署并启动刀片服务器,同时还提供了各种有用的工具,可简化日常管理任务,对潜在问题发出警告,并帮助您修复出现的问题

惠普服务

惠普服务部门可以提供全面的服务,帮助您设计、部署、管理和支持IT环境与业务流程。我们拥有69,000 名技术精湛的专业人员和庞大的服务合作伙伴网络,可在整个IT生命周期内提供全球服务,其中包括咨询、集成、外包和支持服务。

惠普金牌服务可持续为您提供支持。惠普金牌服务可提供方便购买且易于使用的成套支持服务,经济高效地升级或延长您的标准保修。它还可以提供不同级别的支持(从基本到关键任务),帮助您降低宕机风险。惠普金牌服务可随ProLiant BL465c G5 刀片服务器一起购买。

推荐的服务产品:

Enhanced Care, 提供基本的服务, 帮助您实现更高的服务器可用性。 ProLiant BL465c G5 — 3年13 x 5同一工作日4小时现场响应硬件支持服务

Continuous Care,推荐的支持级别,当日响应或修理时间。 ProLiant BL465c G5 — 3年24 x 7全天候同一工作日4小时现场响应硬件支持服务

Total Care, 全天候响应,通过集成的软硬件支持解决复杂的问题。 Proliant BL465c G5 — 3年24×7全天候24小时增强系统支持服务

部署服务,包括惠普安装与启动服务,旨在缩短Proliant刀片服务 器的部署时间,降低部署风险与难度。

ProLiant BL465c G5 — BladeSystem c-Class基础设施安装与启动服务

欲了解更多信息,请访问:

www.hp.com/services/bladesystemservices

最轻松的IT投资方式

惠普金融服务提供了创新的融资和金融资产管理计划, 来帮助您经济高效地购置、管理您的惠普解决方案,直 至最终的产品更新换代。如欲了解更多信息,请联系当 地的惠普销售代表或访问

www.hp.com/go/hpfinancialservices

更多信息

欲了解更多关于HP ProLiant BL465c G5 刀片服务器的信息,请联系您当地的惠普销售代表或访问

www.hp.com/servers/bl465c

要与其他刀片产品客户、合作伙伴和专家联系,请访问 HP Blade Connect 在线社区:

www.hp.com/go/bladeconnect

¹ Sine Nomine Associates,《采用HP Thermal Logic技术的HP BladeSystem与同类系统的对比》,2007年2月。

科技以推动业务成效为本

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.本文所含信息如有更改,恕不另行通知。惠普产品和服务的保修条款在这些产品和服务附带的保修声明中已阐明。本文中的任何信息均不构成额外的保修条款。惠普对文中包含的技术或编辑上的错误或遗漏概不负责。

AMD、AMD箭头标识、AMD Opteron 及其组合均为 Advanced Micro Devices 公司的商标。

